

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃	保存温度範囲	-10℃ ～ 50℃（梱包状態）	
	電 圧	AC / DC 50 V	使用・保存湿度範囲	相対湿度90%以下（結露しないこと）	
	電 流	0.5 A (全芯数通電する場合は×70%)	適合ケーブル	端末導体部： t=0.3±0.05mm， 接触部： 金めっき GNDプレート部： t=0.5±0.05mm， 接触部： 錫めっき	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電氣的性能	耐電圧	AC 150 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	○
機械的性	接触抵抗	開回路電圧 AC 20mV以下，1 mA で測定する。	100 mΩ以下 ※ FFC 導体抵抗を含む。(L=8mm)	○	○
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz，片振幅 0.75mm， 3 軸方向各 10 サイクル試験する。	① 1 μS以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 100 mΩ以下 ③ 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	—
環境性能	衝撃	加速度 981 m/s ² ，持続時間 6 ms， 正弦半波 3 方向各 3 回試験する。		○	—
	繰返し動作	20 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下 ② 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	—
	FFC保持力	適合FFCで測定する。 (初期，FFC端末導体部厚 t=0.30mm、 GNDプレート部厚 t=0.50mm)	かん合方向 0.3×極数N以上	○	—
環境性能	塩水噴霧	温度 35±2℃，濃度 5 % の塩水噴霧中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下 ② 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。 ③ はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -40→+15～+35→+85→+15～+35℃ 時間 30→ 2～3 → 30→ 2～3 分 に 5 サイクル放置する。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 50 MΩ以上 ③ 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	—
	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃，相対湿度 90～95 %中に 96時間放置する。		○	—
	温湿度サイクルの耐湿性	温度 -10～+65℃，相対湿度 90～96 %中に 10 サイクル(240 時間) 放置する。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 1 MΩ以上(高湿時) ③ 絶縁抵抗： 50 MΩ以上(乾燥時) ④ 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐熱性	温度 85±2℃中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下	○	—
	耐寒性	温度 -40±3℃中に 96 時間放置する。	② 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄 〔JIS C 0090〕	温度 40±2℃，相対湿度 80±5%， 濃度 25±5 ppmに 96 時間放置する。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下 ② 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	—
	硫化水素 〔JIS C 0092〕	温度 40±2℃，相対湿度 80±5%， 濃度 10～15 ppmに 96 時間放置する。	③ はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245℃，浸せき時間 2 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—
はんだ耐熱性	1)リフローの場合 ヒート温度 250℃MAX リフロー部温度 230℃以上 60秒以内 2)はんだこての場合 350±5℃ 5秒間	外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○	—	
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	MO. ISHIDA	10.06.08
			検 図	YN. TAKASHITA	10.06.08
			担 当	SJ. OKAMURA	10.06.08
			製 図	SJ. OKAMURA	10.06.08
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-332362-00	
HRS	製品規格表		製品名	FH48-**S-0.5SV	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL580	△ 1/1